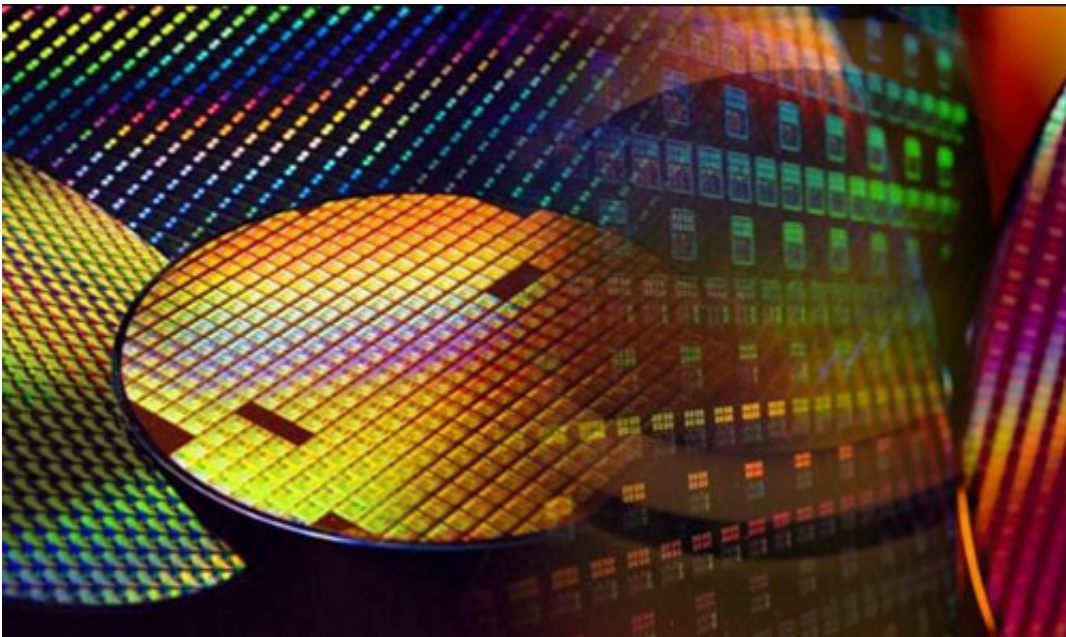


## 三星电子和台积电为晶圆代工激烈竞争

12月1日外媒消息，报道三星和台积电在竞争，这些年晶圆代工方面，三星电子在制程工艺方面基本能跟上台积电的节奏，三星电子和台积电为晶圆代工激烈竞争，在3nm制程工艺上更是率先量产，台积电也是三星电子在晶圆代工领域的主要竞争对手。



而外媒最新的报道显示，三星电子和台积电这两大晶圆代工商，正为争夺晶圆代工客户而激烈竞争。

从外媒的报道来看，高通、英伟达、特斯拉等主要的晶圆代工客户，都在调整他们的策略，减少对单一晶圆代工商的依赖。

在减少对单一厂商的依赖方面，外媒提到的就有高通。本周有报道称高

通新推出的骁龙 8 Gen 2 移动平台，将由三星电子和台积电两家厂商采用 4nm 制程工艺代工，标准版将由台积电代工，性能改善的定制版将由三星电子代工。

高通此前推出的骁龙系列旗舰移动平台，通常是由三星电子代工，骁龙 8 Gen 1 就是由三星电子代工，但在今年 5 月份推出的骁龙 8+ Gen 1 移动平台上，高通又是同台积电合作。

业内人士认为，高通将骁龙 8 Gen 2 移动平台的部分订单交由三星电子，意味着三星电子的尖端工艺在一定程度上赢得了高通的信任。

虽然获得了高通骁龙 8 Gen 2 移动平台的部分订单，但外媒称由于担心 4nm 和 5nm 制程工艺的良品率，三星电子的部分客户也转向了台积电。三星电子的大客户英伟达，在 9 月份推出的 RTX40 系列就选择与台积电合作；近期也有报道称特斯拉，已将下一代全自动驾驶所需的半导体部件交由台积电代工。

本文链接：<https://dqcm.net/zixun/1669910615987.html>